

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-026

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币70,000.00万元，融资品种包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本次融资额度及授权生效后，将覆盖公司第三届董事会第二次会议审议批准的融资额度及授权。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要，拟提请股东会授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日